**苏州国芯科技股份有限公司**

**2023年9月13日-14日投资者关系活动记录表**

**证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2023-013**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 中欧基金；海富通基金；中信保诚基金；国联安基金；金鹰基金；华福证券；华西证券；东方证券；野村东方资管；上海银叶投资；苏州君榕资管； |
| **时间** | 2023年9月13日10：00；2023年9月14日13：30 |
| **地点** | 公司现场交流 |
| **上市公司参加人员姓名** | 董事会秘书：黄涛先生； |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **请介绍下公司第一代汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片产品“CCL1600B”？**

答：公司成功研发的CCL1600B芯片产品是基于公司高压混合信号平台研发的第一代安全气囊点火驱动专用芯片，该款新产品在芯片资源和配置上跟国内多家一线汽车厂商做了深入沟通和调研，可以满足这些厂商在安全气囊领域的应用需求，封装形式为TQFP128epad，型号分为CCL1600B1L4（不带CAN功能）和CCL1600B2L4(带CAN功能)，可实现对国外产品如博世CG90X系列以及ST（意法半 导体）的L9679系列相应产品的替代。芯片提供多达16路安全气囊点火回路，6路PSI5传感器接口，10路电阻或霍尔元件检测通路，2路高压PWM输出接口，具有增强的安全检测和自动诊断功能，芯片还配置了功能强大的电源系统，一颗芯片就解决了ECU（电子控制单元）内部其他芯片的供电问题，同时还集成了一路CAN物理接口（CCL1600B2L4型号支持）。CCL1600B芯片按照汽车电子等级进行设计 和生产，有望为解决我国汽车产业“缺芯”问题做出贡献。公司对上述芯片产品具有完全自主知识产权，并采用和国内头部车企协同创新的合作方式，产品开发阶段就受到国内汽车整机厂商的关注和开发支持，目前该款芯片已在多个客户处进行应用测试和路测，公司将积极推动尽快实现产业化应用。该款新产品的研发成功可实现对目前在国内该领域占据主导地位的国外相应产品的替代，有利于打破国外垄断。该款新产品的研发成功也进一步丰富了公司的汽车电子产品线，有助于公司从MCU系列产品线拓宽到模数混合专用芯片领域，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极影响。**2、请问边缘计算业务发展情况怎样？**答：在边缘计算和网络通信领域，公司研发的芯片具备多核计算、网络路径和协议加速引擎、路由转发以及多种高速通信接口，适用于边缘计算与网络通信领域产品的计算、安全及通信需求。公司完成了高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制器芯片H2040、H2048、H2068和CCP1080T的研发，芯片功能和性能指标满足设计需求，可实现对国外产品如NXP的P4040、MPC8548、MPC8568、T1022等系列产品的替代。高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制器芯片H2040，基于28nm工艺设计，采用国芯32位四核的PowerPC指令架构CPU核，集成DDR3.0、PCIe3.0、千兆网、SATA2.0、RapidIO2.0等接口。该芯片处于国内先进水平。目前，已经完成芯片测试，功能和性能指标满足设计需求，进入市场推广。高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制芯片CCP1080T，基于14nm工艺设计，采用国芯64 位多核PowerPC 架构CPU核，集成高性能密码算法引擎、网络数据加速引擎等，具有万兆网、PCIe3.0、USB3.0等高速接口。可实现对国外产品如NXP的T1022等系列相应产品的替代。完成芯片测试，功能和性能指标满足设计需求，进入市场推广。**3、请说明一下边缘计算的在手订单情况？**答：截至2023年6月30日，边缘计算（高性能计算）和人工智能业务的在手订单为4.13亿元。下半年，公司会继续开拓新的订单，并加强在手订单的执行工作，做好技术支持服务和产能的保障工作，尽最大努力促进业务按约定推进。**4、请说明下汽车电子芯片的技术产品开发和应用情况？**答：公司的汽车电子芯片产品主要集中在MCU、SoC和数模混合芯片等车用核心芯片系列方面，覆盖面较全，截至2023年6月30日公司已在汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用SoC芯片等7条产品线上实现系列化布局，同时积极发展线控底盘芯片、仪表芯片、安全气囊芯片、辅助驾驶处理芯片和智能传感芯片等5类新的芯片产品，拓展汽车电子芯片产品的宽度和深度，在汽车车身及网关控制、动力总成、域控制、线控底盘、车联网信息安全等领域均实现量产装车。 在汽车电子芯片领域，今年上半年，各Tier1厂商和主机厂均面临降低芯片库存的压力，汽车电子芯片短期内总体上需求不足，但国产替代的整体趋势未发生变化，汽车产业向电动化、智能化和网联化的转变愈发强烈，其中新能源车对于芯片的需要将会更加旺盛。面对这些复杂的外部环境的影响，公司在进行高强度的研发投入和系列化的产品推出以外，还加大了汽车电子市场的推广，在保持车身控制及动力总成市场应用之外，积极拓展线控底盘、域控、安全气囊和车联网信息安全等领域的重要客户，并取得了多个项目定点开发、量产的进展。公司汽车电子芯片陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、长安、长城、一汽、东风、小鹏等众多汽车整机厂商，在20余款自主及合资品牌汽车上实现批量应用。2023年上半年，公司以各领域头部企业作为市场推广的重要目标，聚焦大客户，集中优势技术支持来推动大客户、大项目的开发测试及量产。同时以MCU+模式与客户全面合作，即以MCU、混合信号（含驱动类）和通信接口芯片的整体方案来解决客户的“套片”方案式需求，增进与客户合作的广度、深度和粘性，汽车电子优质客户持续增加，基本覆盖各个领域的头部企业：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **截至2023年6月30日新开发的项目数（个）** | **截至2023年6月30日量产的项目数（个）** |
| **华东** | 22 | 6 |
| **华中及西南** | 5 | 2 |
| **华南** | 18 | 4 |
| **华北** | 8 | 1 |
| **小计** | 56 | 13 |

经过产品开发、DV/PV测试、量产等一系列高标准要求的流程后，客户对公司的汽车电子产品的高可靠性，技术服务支持的及时性、全面性给予高度认可，同时随着客户对汽车电子库存的消耗，汽车电子订单也在持续增加，越来越多客户的项目定点使用国芯汽车电子芯片。  |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年9月 |